

シンポジウム「タッチパネル用新型メタルワイヤーの動向」

【開催日 2015 年 8 月 28 日(金)】

【主催】：公益社団法人化学工学会 エレクトロニクス部会

協賛： 電子S I 連絡協議会(ESIC)、表面技術協会、JIEP、JPCA、
スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会 (MSTE)

(内容)

メタルワイヤーは、最近使用面積が急増している静電容量型タッチパネルにおいて、容量変化を検出するための部材とし欠くべからず部材である。この部材には一般的にはITO(Indium Tin Oxide)の透明導電膜が用いられてきた。ITOと較べて抵抗が低いため、Cuのワイヤー(メッシュ状の配線)がデジタルシグネージ(電子看板)用途の大型タッチパネルに用いられている。これらのメタルワイヤーがITOに置き替わるためには、配線幅の微細化と低コスト化が不可欠である。この新型メタルワイヤーを議論する。

- ・日 時 : 2015 年 8 月 28 日(金) 13:00-16:00 懇親会 16:20-18:40
- ・会 場 : 東京工業大学 博物館・百年記念館 3階 フェライト記念会議室
募集人員 100名 申込先着順で、定員になり次第締め切ります。
- ・参加費 : 当日受付にてお支払い下さい。領収書を用意します。

大学関係者・学生	無 料
化学工学会エレクトロニクス部会の個人会員、団体会員会社の社員	2 0 0 0 円
上記以外の化学工学会会員	5 0 0 0 円
電子S I 連絡協議会 (ESIC)、表面技術協会、JIEP、JPCA、MSTE各会員	5 0 0 0 円
その他 一般	1 0 0 0 0 円
- ・懇親会 : 3 0 0 0 円

プログラム

- ・タッチパネル市場とメタルメッシュフィルムの技術動向
タッチパネル研究所 中谷 健司
- ・タッチパネル用 Cu メッシュセンサーへの要求特性
シャープ 宮本雅之
- ・微小銅めっき Cu メッシュの開発
大阪府立大学 近藤和夫
- ・マイクロ波の銀ナノワイヤーへの応用展開とスケールアップ
マイクロ波化学株式会社 塚原保徳

オーガナイザー：大阪府立大学 近藤和夫

* 申込先：E-Mail：electro@chemeng.osakafu-u.ac.jp、大阪府立大学・近藤研究室・山本

Tel：072-254-9304

下記の事項を、必ず、明記の上、申し込むこと。

- 1.氏名 (フリ仮名要)
- 2.勤務先住所 (所属部署まで)
- 3.メールアドレス
- 4.Tel/ Fax
- 5.懇親会参加の有無
- 6.会員資格 (化学工学会会員 ・ 化学工学会エレクトロニクス部会員と団体会員の社員・ ESIC ・ 表面技術協会・JPCA ・ JIEP ・ その他一般・大学関係者)